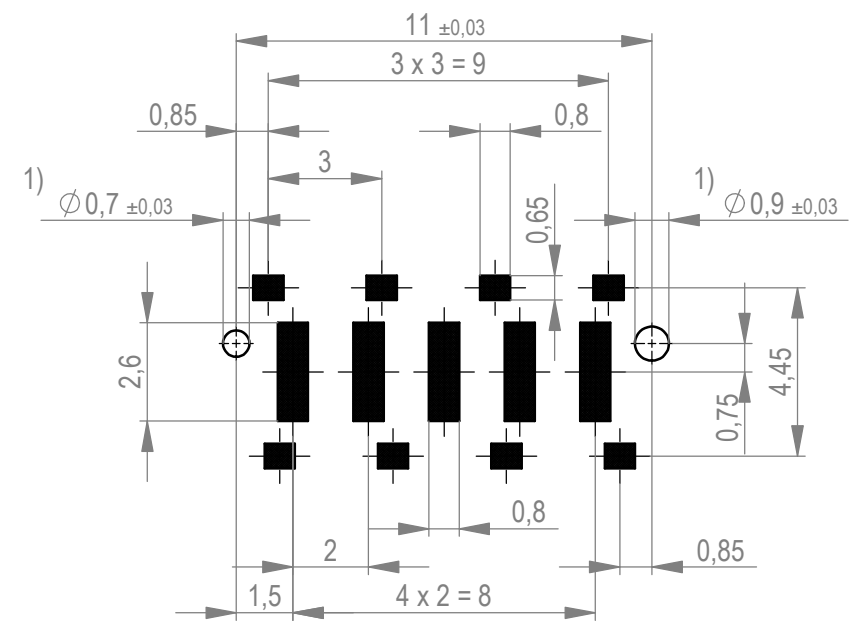


Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-layout proposal



1) Durchmesser des Bohrers / Drill tool

- Anforderungsstufe 1
performance level 1
- Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating
- Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating
- Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterertragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen von dem englischen Original gilt das englische Original. The german version of this drawing has been offered for convenience only and may deviate from the english original. In case of any deviation the English version shall prevail.

Dimension no.	Tolerances		Scale	5:1
	ISO 8015	All Dimensions in mm	Material	
Customer drawing:	This Drawing is a controlled Document.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	
			F08 MSPEED BlindMate PM SMD	
b1	18.05.2023		C-354266-E	
Index	Date		Class	MSPEED
				c A3